

## **Erläuterungen und Hinweise zum Bestückungsplan und Aufbau**

- Beim Bohren der Leiterplatte ist darauf zu achten, daß keine Leiterzüge auf der Gegenseite durchgebohrt werden. Diese Gefahr besteht besonders im Bildteil bei den Schaltkreisen IS 36, IS 37, IS 50, IS 75, IS 67, IS 68, IS 70, IS 71.
- Im Zählteil ist es günstiger, an einigen Stellen die Bohrungen zu versenken, so daß die Lötfläche auf der Bestückungsseite größer wird.
- Die Brücken unter IS 82 und IS 43 müssen unbedingt vor dem Bestücken eingesetzt werden.
- Die Verbindungen zwischen IS 80 und IS 75 sind vor dem Bestücken zu legen, so daß diese unter den Speicherschaltkreisen liegen. Die Brücken werden nur von der Bestückungsseite auf der Seite des IS 75 flach aufgelötet (nicht bohren).
- Treten bei der Inbetriebnahme RAM-Fehler auf, so sind die Schaltkreise IS 14 und IS 15 mit Blockkondensatoren von ca. 47  $\mu\text{F}$  zu versehen.
- Hinweise, die im Bestückungsplan gekennzeichnet sind:
  1. auf der Bestückungsseite auf Masse löteten
  2. von der Leiterseite ansenken
  3. Brücken auf der Leiterseite
  4. Verbindung IS 50/13 nach IS 75/15 auf der Bestückungsseite trennen
  5. IS 71/13 von oben ansenken und Verbindungsleitung nach Pin 12 von oben ziehen
  6. Verbindung auf Leiterseite von IS 64/2 nach IS 65/13 trennen
  7. C11 muß von der Bestückungsseite aus aufgelötet werden (keine Löttaugen vorhanden!)